附件1

厦门市集成电路产业发展专项资金申报指南

申报单位按照以下内容和要求组织开展申报工作。

一、政策适用范围及申报主体

适用于本市行政区域内具有独立法人资格，符合国家产业发展方向，具有5人以上稳定技术团队（在本市签订劳动合同、缴交社保），有一定数量知识产权和固定研发生产经营场所，项目在本市实施，且经厦门市工业和信息化局（以下简称“市工信局”）确认，专门从事集成电路领域（包括EDA工具、逻辑电路、存储器、特色工艺半导体、化合物半导体、微机电系统与智能传感器、基础电子元器件、Mini/Micro LED、OLED、激光显示等）设计、制造、封装测试、装备与材料的研发及生产、公共服务的单位。

二、申报程序

（一）网上申报：申报主体使用法人账号登录厦门市惠企政策“免申即享”平台（https://msjx.xmdanao.com）或者登录厦门市企业服务总门户“慧企云”平台（https://www.xmsme.cn），进入“免申即享”页面，选择集成电路相关申报项目，点击“兑现意愿确认”，进入申报详情页核实企业信息并按要求填写项目申请表、上传申报材料。申报材料需加盖单位公章后上传申报系统（表格需另外上传Excel版）。

（二）纸质件备查：待申报系统显示申报材料通过预审后，申报主体可登录系统打印相关材料一式一份备查，所有材料须加盖公章，纸质材料应与上传的电子版材料一致。

（三）现场核查：申报主体需提供本次申报项目的汇总表、相关合同、票据等材料的原件及上一年度人才资金发放凭证备查。

（四）申报和审批流程：企业申报—线上初审—现场核查—专家评审—查重—信用及涉黑情况查询—内审会—公示—资金拨付。

三、基本情况材料

（一）申报企业基本情况表（附件1）。

（二）信用承诺书（附件2）。

四、项目申报材料

**第一类 支持人才引进**

**（一）高端人才安家补助**

1.申报条件：

（1）2023年1月1日起新引进的。

（2）经市工信局审核确认符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准（试行）》。

2.补助标准：

A类、B类、C类集成电路高端人才，分别给予100万元、50万元、30万元补助，按40%、30%、30%的比例分3年发放。

3.申报材料：

（1）厦门市集成电路产业高端人才申报书（附件3-1）。

（2）集成电路高端人才安家补助资金汇总表（附件3-2）。

（3）①首次申请人员提供身份证（境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件）、学位证书、劳动合同复印件；个人社保缴费情况证明、个人所得税明细申报情况清单。国（境）外人才须提供合法的入境证明和出入境记录。②非首次申请人员仅需提供个人社保缴费情况记录。

（4）符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准（试行）》相应人才类别（A、B、C类）资格条件的相关证明材料。包括但不限于获得其他单位人才认定文件复印件；专业技术职务资格证书、聘书复印件；所获奖项、荣誉、职称、专利、论文等。外文材料需提供翻译件。

（5）半导体公司排名须参照国际级研究机构IC Insights、Trendforce、Gartner、IDC或IHS、中国半导体行业协会、台湾半导体产业协会发布的最新年度企业排名，证明材料需提供网络截图及链接，注明企业排名次序。

（6）集成电路重点企业年度销售额以企业所得税汇算清缴报告为准。

4.备注：

（1）市工信局采取竞争性专家评审方式组织认定，认定后直接兑现补助。

（2）新引进时间以在厦缴纳个税或社保起始时间为准（台湾人才按在厦缴纳个税时间为准）。

（3）此项政策可在现有人才政策的基础上叠加享受。

（4）资金申报及兑现时在职。

**（二）毕业生就业补助**

1.申报条件：

（1）具有全日制本科以上学历、专业符合《厦门市集成电路产业相关紧缺专业目录》（附件4-1）。

（2）2022年1月1日—2024年12月31日期间毕业且到本市集成电路领域企业就业。

（3）与本市集成电路企业签订2年以上的劳动合同。

（4）资金申报及兑现时在职。

2.补助标准：

本科生18000元/年、硕士生30000元/年、博士生42000元/年给予补助，以实际缴纳社会保险金月数核算补助金额，本次核算补助的时间范围为2024年1月—2024年12月，每名毕业生累计可获补助不超过2年。

3.申报材料：

（1）毕业生就业补助资金汇总表（附件4-2）。

（2）①首次申请人员身份证（境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件）、毕业证书、学位证书、劳动合同复印件、个人社保缴费情况记录；②非首次申请人员仅需提供个人社保缴费情况记录。如果学历发生变动还需补充毕业证书、学位证书复印件；如果单位发生变动还需补充劳动合同复印件。

4.备注：

（1）毕业生就业补助与市人社局新引进人才生活补助就高不重复。一经查重发现，即视为已享受补助。

（2）个人社保缴费情况记录需提供至最新缴费记录。

**第二类 支持研发创新**

**（三）流片补助**

1.申报条件：

完成多项目晶圆流片或首次完成全掩膜工程产品流片的集成电路设计企业、高校或科研院所。

2.补助标准：

（1）用于研发的多项目晶圆流片补助。①集成电路企业按照直接流片费用的60%给予补助；②高校或科研院所按照直接流片费用的70%给予补助。

（2）首次完成全掩膜工程产品流片补助。集成电路设计企业完成的全掩膜工程产品，按照产品首次流片（含Foundry IP授权、掩膜版制作、晶圆片等，晶圆片数量超过12片的，按12片核算）费用的30%给予补助。

（3）利用符合条件的集成电路生产线首次完成全掩膜工程产品流片补助。集成电路设计企业完成的全掩膜工程产品，按照产品首次流片（含Foundry IP授权、掩膜版制作、晶圆片等，晶圆片数量超过12片的，按12片核算）费用的40%给予补助。

（4）每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3.申报材料：

1. 流片补助资金申请表（附件5-1）。
2. 流片补助资金汇总表（附件5-2）。
3. 项目研发说明（包括产品类型、产品概述、产品技术先进性、产品经济效益等）。
4. 芯片版图缩略图（需用彩印）、产品外观照片。
5. 晶圆厂流片项目订单或合同、发票、付款凭证（境外加工的需提供报关单或委外加工证明）、EDA正版软件使用证明；流片项目应包含光罩（层）、晶圆（张），单据金额和申报金额如果有不一致需做说明。
6. 多项目晶圆项目需要提供以下说明之一：晶圆厂主导的多项目晶圆项目，应在合同上体现；企业自主多项目晶圆项目，需提供图示说明此套光罩所包含的项目；企业采用多合一复合板，需提供多合一板图示说明。

4.备注：

（1）通过第三方流片的，需提供第三方与晶圆厂的代理关系佐证材料。包括但不限于第三方与晶圆厂的代理协议、流片合同、发票等。

（2）境外流片报关进口时造成损坏的部分需在申报时扣除并在《流片补助资金汇总表》内备注。

（3）具体时间以流片发票日期为准，光罩、晶圆发票跨年度的，以晶圆发票时间为准。

（4）外文材料需提供翻译件。

（5）此项政策可在现有企业研发费用补助普惠政策的基础上叠加享受。

**（四）IP购买补助**

1.申报条件：

（1）本市集成电路设计企业，购买IP用于集成电路线宽小于0.25微米（含）等高端芯片研发，购买IP后需向市工信局报备。

（2）提供方应为专业IP提供商或设计机构，且成立三年以上。

（3）购买方与提供方应为非关联关系，且已签订转让或授权合同，完成合同付款，完成多项目晶圆或工程流片。

2.补助标准：

对符合条件的企业按照IP购买直接费用的30%给予补助，每个单位年度补助总额最高不超过200万元。

3.申报材料：

（1）IP购买补助资金申请表（附件6-1）。

（2）IP购买补助资金汇总表（附件6-2）。

（3）IP核使用情况说明、IP使用原理图以及模块图、产品版图（附IP位置标注），企业购买的IP核实施转化运作的佐证材料（完成多项目晶圆或工程流片，包括不限于：流片、验证报告等）。

（4）IP转让或授权许可合同、发票及银行支付凭证等。

（5）合同双方的非关联声明或相关佐证材料。

4.备注：

（1）IP购买包括授权、转让等形式。

（2）本条款“购买IP用于研发”特指因芯片研发需要而进行的IP核复用，包括软核IP、固核IP、硬核IP等，不包含专利、软件著作权等，IP核占芯片版图面积不应超过合理比例。

（3）外文材料需提供翻译件。

（4）具体时间以购买的IP核应用的产品首次流片发票日期为准。

（5）此项政策可在现有企业研发费用补助普惠政策的基础上叠加享受。

**（五）EDA工具购买补助**

1.申报条件：

本市集成电路设计企业，购买EDA工具由本企业使用。

2.补助标准：

（1）对集成电路设计企业购买EDA工具软件的，按照实际发生费用的20%给予补助。

（2）对集成电路设计企业购买国产EDA工具软件的，按照实际发生费用的30%给予补助。

（3）每个单位年度补助总额最高不超过300万元。

3.申报材料：

（1）EDA工具购买补助资金汇总表（附件7）。

（2）购买EDA工具必要性说明（包括购买的模块、版本、功能等基本信息，供应商行业地位概述，工具优势说明）。

（3）购买合同、发票及银行支付凭证等。

4.备注：

（1）外文材料需提供翻译件。

（2）具体时间以发票日期为准。

（3）此项政策可在现有企业研发费用补助普惠政策的基础上叠加享受。

**第三类 支持提质增效**

**（六）设备购买补助**

1.申报条件：

（1）本市集成电路设计、制造、封测、装备和材料企业，申请的设备须在厦门本地，且已投入使用。

（2）购买的设备须为光刻设备、薄膜设备、刻蚀清洗设备、离子注入及扩散设备、研磨抛光设备、封装测试设备、检测设备等核心设备。

2.补助标准：

（1）对购买国（境）外厂商配套的核心设备的，按采购金额的5%给予补助。

（2）对购买国内厂商配套的核心设备的，按采购金额的10%给予补助。

（3）每个单位年度补助总额最高不超过1000万元。

3.申报材料：

（1）设备购买补助资金汇总表（附件8）。

（2）项目合同、发票及银行支付凭证复印件（境外购置设备的需提供进口报关单）。

4.备注：

（1）购置国内设备以增值税专用发票日期为准；购置进口设备以海关报关单日期为准。

（2）申报时尾款未结清的，可放宽至下一年度申报。

（3）外文材料需提供翻译件。

（4）此项政策可在现有设备补助普惠政策的基础上叠加享受。

**（七）设备融资租赁补助**

1.申报条件：

（1）本市集成电路设计、制造、封测、装备和材料企业，通过设备融资租赁方式开展项目建设，申请的设备须在厦门本地，且已投入使用。

（2）申请的设备须为光刻设备、薄膜设备、刻蚀清洗设备、离子注入及扩散设备、研磨抛光设备、封装测试设备、检测设备等核心设备。

2.补助标准：

按照设备融资租赁费用（手续费、利息）的20%给予补助，每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3.申报材料：

（1）设备融资租赁补助资金汇总表（附件9）。

（2）项目合同、证明融资租赁手续费、利息费用的发票及银行支付凭证复印件（通过境外融资租赁企业租赁设备的需提供进口报关单）。

（3）融资租赁企业设备采购合同、发票等相关凭证。

4.备注：

（1）融资租赁国内设备以增值税专用发票时间为准；融资租赁进口设备以海关报关单申报日期为准。

（2）外文材料需提供翻译件。

**（八）电力稳压系统补助**

1.申报条件：

（1）本市集成电路制造、封装测试企业，申请的电力稳压设备须在厦门本地，且已投入使用。

（2）项目电压等级达到10kV（含）以上，稳压设备符合《电力稳压系统设备清单》（附件10-1）。

2.补助标准：

实际设备投资额的20%的补助，每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3.申报材料：

（1）电力稳压系统补助资金汇总表（附件10-2）。

（2）项目电压等级的相关佐证材料。

（3）项目合同、发票及银行支付凭证复印件（境外购置设备的需提供进口报关单）。

4.备注：购置国内设备以增值税专用发票日期为准；购置进口设备以海关报关单日期为准。

**（九）洁净室装修补助**

1.申报条件：

（1）本市集成电路设计、制造、封测、装备和材料企业，且洁净室已投入使用。

（2）洁净室等级须达到千级及以上。

2.补助标准：

洁净室装修实际造价的20%给予补助，每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3.申报材料：

（1）洁净室装修补助资金汇总表（附件11）。

（2）洁净室等级的相关佐证材料。

（3）项目合同、发票及银行支付凭证复印件。

4.备注：具体时间以发票日期为准。

**第四类 支持生态建设**

**（十）芯片采购补助**

1.申报条件：

（1）年销售额1亿元以上的系统（整机、终端、模组）企业。

（2）企业采购符合条件的集成电路企业设计、生产的芯片，且用于本市工厂产品的生产制造。

（3）向关联企业的采购不计入补助核算采购费用总额。

2.补助标准：

按采购额的10%给予补助，每个单位年度补助总额最高不超过100万元，补助期限累计不超过3年。

3.申报材料：

（1）芯片采购补助资金汇总表（附件12）。

（2）专项审计报告（内容须包含但不限于年度主要产品销售收入、采购项目情况等）；企业年度销售额以企业所得税汇算清缴报告为准。

 （3）芯片应用在整机、终端、模组上的相关佐证材料。

（4）采购合同、发票及银行支付凭证等。

（5）双方签章的非关联声明或相关佐证材料。

4.备注：

（1）企业采购的芯片需为本市集成电路企业设计并量产。

（2）具体时间以采购发票日期为准。

**（十一）封装测试补助**

1.申报条件：

（1）本市集成电路设计企业。

（2）集成电路设计企业首年度利用符合条件的生产线进行封装测试。

（3）在关联企业进行封装测试的不计入补助核算费用总额。

2.补助标准：

按封装测试费用的50%给予补助，每个单位年度补助总额最高不超过100万元。

3.申报材料：

（1）封装测试补助资金汇总表（附件13）。

（2）项目说明（包括产品概述、封装类型、测试方式等），项目相关文档、图片。

（3）项目订单或合同、发票、付款凭证、结算明细表等。

4.备注：

（1）“首年度利用符合条件的生产线进行封装测试”是指本市集成电路设计企业与本市集成电路封装测试企业第一年合作。

（2）具体时间以发票日期为准。

**（十二）支持公共服务平台提升服务能力**

1.申报条件：

（1）本市集成电路产业公共服务平台。

 （2）公共服务平台每年度为50家以上企业提供技术研发支撑、流片代理、人才培训等服务。

2.补助标准：

按服务收入的30%给予平台奖励，每个平台年度奖励总额最高不超过100万元。

3.申报材料：

（1）支持公共服务平台提升服务能力补助资金汇总表（附件14）。

（2）服务合同、发票及银行收款凭证等。

4.备注：具体时间以发票日期为准。

**（十三）支持举办行业活动**

1.申报条件：

经报市工信局同意，在本市组织举办全国性创新创业大赛、行业年会、产业大会、产业论坛等以推动产业发展为目的的非营利性活动。

2.补助标准：

对活动场租费、交通费、资料费及专家差旅费、食宿费等支出的50%给予补助，每场活动补助最高不超过100万元。

3.申报材料：

（1）支持举办行业活动补助资金汇总表（附件15）。

（2）专项审计报告。

（3）发票及银行付款凭证等。

4.备注：

（1）需先提供活动方案报市工信局同意。

（2）具体时间以发票日期为准。

五、其他注意事项

（一）申报主体应对所提交申报材料的真实性、完整性负责。若因申报材料不真实、不完整等造成申报失败或无法享受政策的后果由申报主体自行承担。

（二）政策中除“高端人才安家补助”“流片补助”“IP购买补助”“EDA工具购买补助”“设备购买补助”等5项政策可与现有相关同类补助政策叠加享受外，其余申报项目应符合“项目承担单位的同一项目或内容相近的项目如符合一个以上市级财政扶持资金申报要求的，只能选择其中一个专项扶持资金申报”等要求。

（三）“一企一策”与普惠政策不重复享受。

（四）申报单位或个人、财审机构应在信用厦门平台无提示、警示信息，未列入失信联合惩戒范围，未出现涉黑涉恶问题。对于发生生产安全责任事故的，执行联合惩戒规定。

（五）本申报指南中各项目的补助金额核算基数均以已付款票据（不含税）为准。

（六）本政策对项目实际补助的额度受专项资金年度预算总额控制。